

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。本節內容僅為概要，並未包括可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下決定投資H股前，務請閱讀整份文件。

任何H股投資均涉及風險。有關投資H股的若干特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定投資H股前，務請仔細閱讀該節。

我們是誰

我們是領先的系統級半導體設計廠商，面向智慧家庭、智慧辦公、智慧出行、娛樂教育、工業生產場景，提供卓越的智能終端控制與連接解決方案，包括智能多媒體與顯示SoC主控芯片、AIoT SoC主控芯片、通信與連接芯片、智能汽車SoC芯片等，致力於賦能全球智能終端從萬物互聯走向萬物智聯。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年的相關收入計，我們在專注於智能終端SoC芯片的廠商中位列全球第四（全球市場份額為1.2%），在家庭智能終端SoC芯片領域位列中國大陸第一、全球第二（全球市場份額為17.7%）。

我們自成立以來即聚焦於具備高系統複雜性和多維度疊加技術的系統級SoC芯片，已深耕SoC芯片設計30年，形成覆蓋神經網絡處理器NPU、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內存系統、安全系統、廣域網／局域網網絡接口、輸入輸出子系統等多功能模塊高度全棧自研技術矩陣，可廣泛適配多元智能終端場景需求。我們亦致力於通信與連接芯片的研發，經過10餘年自研IP迭代打磨，在基帶、射頻、協議棧等關鍵領域取得重大進展，我們的自研無線通訊Wi-Fi芯片和LTE芯片可高度適配我們的SoC芯片，滿足更多元的AIoT場景需求。

我們的SoC及芯片產品可直接集成到一系列終端消費電子產品中，如智能電視、機頂盒及智能家居設備。通常，我們的終端客戶於製成品製造過程中以組件級形式集成我們的產品。例如，就智能電視SoC而言，電視製造商將我們的SoC作為主芯片焊接到主板上，與硬件及軟件協同工作，以提供顯示屏驅動、智能控制及網絡連接等基本功能。我們的智能電視SoC已成為小米及海信等領先電視品牌商生產的智能電視的主要處理單元，可實現4K視頻解碼及AI畫質優化等高級功能。

概 要

我們在全球範圍深耕智慧家庭生活這一廣闊賽道，瞄準大市場，把握增長機會，確立領先地位，締造了極大的商業成功，並構築了極高的商業壁壘。截至2025年12月31日，我們的芯片累計出貨量超10億顆。根據弗若斯特沙利文提供的資料，2024年，全球每3台智能機頂盒即搭載一顆我們的智能機頂盒芯片、每5台智能電視即搭載一顆我們的智能電視芯片。我們的業務遍佈全球，覆蓋全球主流運營商270餘家、全球領先的電視品牌（如海信、TCL及創維）以及眾多AIoT廠商及汽車廠商，已整合至超過100個國家和地區的家庭屏幕中。

競爭優勢

我們相信，我們的業務成功及領先的市場地位乃由以下主要優勢所支撐：(i)強大的系統級SoC創新能力；(ii)豐富的自研IP資源庫，打造可擴展平台化生態體系；(iii)開創端側AI技術與新一代制程技術；(iv)與全球行業領導者及生態系統平台構建長期戰略合作關係；(v)具備敏捷的全球運營與強大的本地化響應能力；及(vi)經驗豐富的管理及研發團隊。請參閱「業務－競爭優勢」。

策略

我們堅定地實施以下戰略，以追求持續發展並實現我們的願景：(i)持續端側AI及通訊與連接技術研發創新，深化智能終端場景佈局；(ii)深耕頭部客戶生態合作，延伸智能終端市場需求；(iii)以強大的人才庫推動產品創新；及(iv)探索戰略投資併購機會，鞏固技術領先。請參閱「業務－戰略」。

我們的業務模式

我們是無晶圓半導體公司，專注於智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片以及智能汽車SoC。憑藉豐富行業經驗及我們的高可複用通用IP資源庫，我們已與多個領域的頭部客戶建立穩固的合作關係。我們的業務足跡遍佈全球，涵蓋中國內地、香港、北美、歐洲、拉丁美洲、亞太及非洲。

我們採取直銷及分銷兩種模式。於2023年、2024年及2025年，我們來自分銷的收入分別佔78.5%、78.3%及78.1%。於往績記錄期間，我們向全球電信運營商、領先的電視品牌商（如小米、創維、TCL、海信、海爾及希沃）以及廣泛AIoT品牌商提供SoC。

概 要

客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括分銷商。於2023年、2024年及2025年各年，我們的五大客戶合計產生的收入分別為人民幣3,519.0百萬元、人民幣3,752.2百萬元及人民幣4,333.9百萬元，分別佔我們總收入的65.5%、63.3%及63.8%。於2023年、2024年及2025年各年，來自我們最大客戶的收入分別為人民幣1,317.4百萬元、人民幣1,109.9百萬元及人民幣1,544.5百萬元，分別佔我們總收入的24.5%、18.8%及22.7%。詳情請參閱「業務－客戶」。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括(i)晶圓廠及(ii)芯片封裝及測試服務提供商。於2023年、2024年及2025年，向五大供應商的採購額分別為人民幣2,817.9百萬元、人民幣3,259.6百萬元及人民幣4,556.7百萬元，分別佔我們採購總額的86.6%、88.0%及79.8%。此外，向最大供應商的採購額分別為人民幣1,776.8百萬元、人民幣1,844.7百萬元及人民幣2,374.2百萬元，分別佔我們於2023年、2024年及2025年採購總額的54.6%、49.8%及41.6%。詳情請參閱「業務－我們的供應商」。

我們自2016年起開始與供應商A（一家全球性公共半導體晶圓代工廠）合作，且已通過長期協議與供應商A建立穩定的關係。根據弗若斯特沙利文提供的資料，芯片設計公司依賴少數晶圓廠合作夥伴以確保品質一致的產品及集中管理生產需求，這符合行業慣例。請參閱「業務－我們的供應商－依賴若干供應商」。

競爭

我們所處的全球智能設備SoC行業極具競爭力，且具有廣泛的下游應用特點。按收入計，全球智能設備SoC市場從2020年的419億美元增加至2024年的657億美元，2020年至2024年的複合年增長率為11.9%。預期於2029年前，全球智能設備SoC市場規模將進一步增至1,314億美元，2024年至2029年的複合年增長率為14.9%。

我們主要與國內外SoC提供商展開競爭，其中部分提供商的市場份額遠高於我們。我們所處市場的主要競爭因素包括技術專長、研發能力、多樣化的可複用IP資產組合、銷售與營銷能力、供應鏈管理以及品牌和聲譽。我們已展示出強大的市場競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年的相關收入計，我們在專注於智能終端SoC芯片的廠商中位列全球第四（全球市場份額為1.2%），在全球智能家庭終端SoC市場中位列中國大陸第一、全球第二（全球市場份額為17.7%）。請參閱「行業概覽」。

概 要

歷史財務資料概要

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告的綜合財務資料（包括隨附附註）及本文件「財務資料」所載資料一併閱讀。

綜合損益表概要

下表載列我們於所示年度的綜合損益表概要。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
收入	5,370,942	100.0	5,926,315	100.0	6,790,582	100.0
銷售成本.....	(3,586,897)	(66.8)	(3,728,253)	(62.9)	(4,224,222)	(62.2)
毛利	1,784,045	33.2	2,198,062	37.1	2,566,360	37.8
其他收入.....	43,273	0.8	21,024	0.4	22,406	0.3
其他收益及虧損淨額	91,187	1.7	100,956	1.7	19,438	0.3
銷售及營銷開支	(88,825)	(1.7)	(71,712)	(1.2)	(86,244)	(1.3)
一般及行政開支	(169,244)	(3.2)	(163,972)	(2.8)	(155,906)	(2.3)
研發開支.....	(1,282,691)	(23.9)	(1,352,730)	(22.8)	(1,551,795)	(22.9)
金融資產減值虧損						
（扣除撥回）.....	(60)	(0.0)	43	0.0	(336)	(0.0)
財務收入淨額.....	86,390	1.6	111,949	1.9	89,711	1.3
應佔聯營公司業績	38,953	0.7	8,195	0.1	5,001	0.1
除稅前利潤.....	503,028	9.4	851,815	14.4	908,635	13.4
所得稅開支.....	(4,335)	(0.1)	(32,604)	(0.6)	(38,168)	(0.6)
年內利潤.....	498,693	9.3	819,211	13.8	870,467	12.8

我們的年內利潤從2023年的人民幣498.7百萬元增加64.3%至2024年的人民幣819.2百萬元，主要由於我們擴大客戶群、下游市場復甦及6納米芯片的商業化進程帶動收入增長人民幣555.4百萬元。我們的年內利潤從2024年的人民幣819.2百萬元進一步增加6.3%至2025年的人民幣870.5百萬元，主要由於我們擴大客戶群及拓闊產品應用場景帶動收入增加人民幣864.3百萬元。

概 要

收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自半導體銷售。下表載列所示期間按業務性質劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
銷售芯片						
智能多媒體及顯示SoC	4,060,358	75.6	4,290,644	72.4	4,948,755	72.9
AIoT SoC	1,200,376	22.3	1,511,255	25.5	1,639,661	24.2
通信與連接芯片	77,111	1.4	119,579	2.0	199,797	2.9
智能汽車SoC及其他芯片	32,039	0.7	4,837	0.1	1,419	-
提供技術服務 ⁽¹⁾	1,058	0.0	-	-	950	-
總計	5,370,942	100.0	5,926,315	100.0	6,790,582	100.0

附註：

(1) 提供技術服務的收入主要與2021年承接的一位客戶的定制化項目的分期付款有關。

根據弗若斯特沙利文的資料，芯片行業在2022年下半年及2023年面臨下滑，表現為庫存積累、消費者需求減少及各類產品價格下降。於2024年，該行業開始出現若干終端市場復甦步伐不一的跡象，而該等市場的競爭仍然十分激烈。受往績記錄期間不同終端市場的週期性衰退和逐步復甦所影響，我們不同產品的銷量於同期出現波動，隨後在2024年復甦。儘管行業週期性衰退，憑藉我們的多元化產品組合及供應鏈管理能力，我們於2023年保持相對穩定的收入總額和整體毛利率。於2025年，基於我們對產品開發和迭代的持續投資，我們可利用全球芯片行業的逐步復甦以及AI和先進智能技術發展所帶來的智能設備需求激增。

概 要

下表載列所示期間按地理位置劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)					
中國內地.....	524,880	9.8	511,958	8.6	615,402	9.1
中國內地以外地區 ⁽¹⁾	4,846,062	90.2	5,414,357	91.4	6,175,180	90.9
總計	5,370,942	100.0	5,926,315	100.0	6,790,582	100.0

附註：

- (1) 我們根據交付地點按地理位置分類收入。基於考慮因素（如物流、商業慣例及外匯結算），我們的客戶通常將香港選為交付地點。

毛利及毛利率

下表載列於所示期間按業務線劃分的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元		人民幣千元		人民幣千元	
		%		%		%
銷售芯片						
智能多媒體及顯示SoC	1,397,531	34.4	1,389,251	32.4	1,768,752	35.7
AIoT SoC.....	522,951	43.6	743,498	49.2	768,057	46.8
通信與連接芯片	20,006	25.9	31,616	26.4	39,049	19.5
智能汽車SoC及其他芯片 ..	14,044	43.8	1,635	33.8	747	52.6
提供技術服務.....	1,058	100.0	-	-	950	100.0
小計／整體	1,955,590	36.3	2,166,000	36.5	2,577,555	38.0
(存貨跌價準備)／撥回						
存貨跌價準備	(171,545)		32,062		(11,195)	
總計／整體	1,784,045	33.2	2,198,062	37.1	2,566,360	37.8

概 要

我們的毛利從2023年的人民幣1,784.0百萬元增加23.2%至2024年的人民幣2,198.1百萬元，主要由於(i)2024年存貨跌價準備撥回淨額(因下游市場需求恢復)；及(ii)我們AIoT SoC以及通信與連接芯片的銷量增加所推動。我們的毛利從2024年的人民幣2,198.1百萬元增加16.8%至2025年的人民幣2,566.4百萬元，主要由於AIoT SoC的銷量增加，部分被存貨跌價準備撥回減少所抵銷。

我們的毛利率從2023年的33.2%提高至2024年的37.1%，主要是由於下游市場需求回溫，導致存貨撇減撥回淨額。於2025年，我們的毛利率維持相對穩定，為37.8%。

綜合財務狀況表概要

下表載列截至所示日期的綜合財務狀況表概要。

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
非流動資產總值	1,208,541	1,533,932	1,961,108
流動資產總值	5,147,520	5,832,098	6,683,008
總資產	6,356,061	7,366,030	8,644,116
非流動負債總額	67,492	55,843	66,671
流動負債總額	799,513	883,619	1,201,492
負債總額	867,005	939,462	1,268,163
流動資產淨值	4,348,007	4,948,479	5,481,516
資產淨值	5,489,056	6,426,568	7,375,953

流動資產淨值

我們的流動資產淨值保持相對穩定，截至2025年12月31日及截至2026年2月28日，分別為人民幣5,481.5百萬元及人民幣5,430.5百萬元。

我們的流動資產淨值從截至2024年12月31日的人民幣4,948.5百萬元增加10.8%至截至2025年12月31日的人民幣5,481.5百萬元，主要由於(i)存貨增加人民幣1,118.1百萬元(主要由於我們根據市場判斷提高存貨水平)，(ii)預付款項增加人民幣384.5百萬元。

概 要

元（主要由於與若干主要供應商的付款安排出現變動（以確保供應鏈穩定性）），及(iii)貿易及其他應收款項增加人民幣171.9百萬元（與銷售額增長一致）。增加部分被(i)按公允價值計入損益的金融資產減少人民幣536.6百萬元（主要與贖回到期理財產品有關）及(ii)現金及銀行結餘減少人民幣393.9百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值從截至2023年12月31日的人民幣4,348.0百萬元增加13.8%至截至2024年12月31日的人民幣4,948.5百萬元，主要由於(i)現金及銀行結餘增加人民幣408.5百萬元，主要反映我們現金流量有所改善，(ii)存貨因市場需求逐步恢復而增加人民幣165.0百萬元，及(iii)按攤銷成本計量的金融資產的流動部分主要由於投資變動而增加人民幣143.9百萬元所致。

資產淨值

我們的資產淨值從截至2023年12月31日的人民幣5,489.1百萬元增加17.1%至截至2024年12月31日的人民幣6,426.6百萬元，主要由於我們錄得年內利潤人民幣819.2百萬元所致。我們的資產淨值從截至2024年12月31日的人民幣6,426.6百萬元增加14.8%至截至2025年12月31日的人民幣7,376.0百萬元，主要由於錄得年內利潤人民幣870.5百萬元所致。

綜合現金流量表概要

下表載列於所示年度的節選現金流量表資料：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
經營活動所得／(所用) 現金淨額	886,961	950,653	(225,435)
投資活動所得／(所用) 現金淨額	(1,112,248)	(938,221)	581,443
融資活動所得／(所用) 現金淨額	(128,363)	17,472	18,969
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額	(353,650)	29,904	374,977
匯率變動影響	4,939	(950)	(14,281)
年初現金及現金等價物	1,129,525	780,814	809,768
年末現金及現金等價物	780,814	809,768	1,170,464

概 要

截至2025年12月31日止年度，我們的經營活動所用現金淨額為人民幣225.4百萬元，主要由於預付款項增加人民幣365.0百萬元，而預付款項增加主要是由於有關我們通過Amlogic Holdings Ltd.的子公司下達晶圓製造訂單與我們若干主要供應商制定的付款安排出現變動（為確保供應鏈穩定），而導致商品預付款項大幅增加所致。請參閱「— 法律訴訟及合規情況 — 出口管制合規安排」。我們預期在Amlogic Holdings Ltd.的子公司可延長與該等主要供應商的信貸期前，將產生經營活動所用現金淨額。我們將繼續密切監察我們的經營活動所得現金流量，並透過多種方式改善我們的經營現金流出淨額狀況，包括(i)延長Amlogic Holdings Ltd.子公司與主要供應商的信貸期，(ii)延長與Amlogic Holdings Ltd.的信貸期，以減少所需的預付款，(iii)透過監察客戶的信貸狀況及改善我們的收款制度管理貿易應收款項及應收票據，及(iv)提高存貨週轉率以增加經營活動所得現金流量。

主要財務比率

下表載列我們截至所示日期或於所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日止年度／截至該日		
	2023年	2024年	2025年
毛利率 ⁽¹⁾	33.2%	37.1%	37.8%
流動比率 ⁽²⁾	6.4	6.6	5.6
速動比率 ⁽³⁾	4.9	5.0	3.5
債務權益比率 ⁽⁴⁾	0.2	0.1	0.2
權益回報率 ⁽⁵⁾	9.6%	13.8%	12.6%

附註：

- (1) 毛利率乃按收入減銷售成本，除以收入，再乘以100%計算。
- (2) 流動比率等於截至所示日期的流動資產總值除以流動負債總額。
- (3) 速動比率乃按所示日期的流動資產減存貨，再除以流動負債計算。
- (4) 債務權益比率按總債務除以總權益計算。
- (5) 權益回報率按年內利潤除以各年度本公司權益（各年度權益期初與期末結餘之和再除以二），再乘以100%計算。

概 要

風險因素

我們的營運及[編纂]涉及若干風險與不確定性，包括(i)與我們的行業及業務營運有關的風險，(ii)與我們產品的研發及知識產權有關的風險，(iii)與我們的財務狀況及額外資本需求有關的風險，(iv)與在我們經營所在司法權區開展業務有關的風險，及(v)與[編纂]有關的風險，該等風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前，應仔細閱讀該節全部內容。

我們面臨的主要風險包括但不限於：(i)我們所處的市場競爭激烈。如果我們無法與現有或新的競爭對手有效競爭，我們的銷售、市場份額及盈利能力可能會受到不利影響；(ii)如果我們不能及時推出具有可為客戶創造價值的特性和性能水平的產品，我們的經營業績可能會受到影響；(iii)對我們客戶的行業和領域造成不利影響的因素可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成不利影響；(iv)我們面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施、出口管制及經濟制裁相關的風險，且我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響；(v)如果產品不符合客戶的規格或有瑕疵，可能會給我們帶來巨大成本或導致業務虧損；(vi)與我們的產品及市場相關的產業標準及技術要求的變更，可能會對我們的業務、經營業績和前景造成不利影響；及(vii)我們從少數供應商採購若干對我們經營關鍵的服務。

法律訴訟及合規情況

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟(包括任何破產或接管程序)。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

概 要

近期發展及無重大不利變動

無重大不利變動

經過董事認為適當的充分盡職調查工作後，董事確認，直至本文件日期，自2025年12月31日（即本文件附錄一會計師報告所報告期間的結束日期）以來，我們的財務或貿易狀況或前景概無任何重大不利變動，且自2025年12月31日以來，未發生任何會對本文件附錄一會計師報告所載資料產生重大影響的事件。

近期發展

2026年初，全球半導體行業保持強勁增長勢頭，主要得益於來自AI相關應用（包括數據中心及智能設備）的強勁需求。AI算力需求持續提升，連同各類應用場景中的芯片含量不斷增加，進一步推動了全球半導體行業的擴張。

於2026年3月，我們批准截至2025年12月31日止年度的現金股息合共人民幣84.0百萬元。請參閱載於本文件附錄一的會計師報告。

我們於上海證券交易所上市的情況及於聯交所上市的理由

本公司自2019年8月起在上海證券交易所科創板上市。我們尋求在香港聯交所上市，以進一步提升本公司的資本實力及綜合競爭力，並推進本公司國際化戰略。詳情請參閱「業務－我們的戰略」及「未來計劃及所得款項用途」。

我們的董事已確認，自我們於上海證券交易所科創板上市起及截至最後實際可行日期，我們概無發生嚴重違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的情形，且據我們的董事經作出一切合理查詢後所深知，並無與我們於上海證券交易所的合規記錄有關的重大事項須提請投資者垂注。中國法律顧問認為，我們並無面臨中國證券監管機構施加的任何重大行政處罰或監管措施，且我們已於所有重大方面遵守上海證券交易所的相關規則及適用於我們的中國其他適用證券法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並未注意到任何事項將導致其不同意董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄作出的確認。

概 要

COVID-19的影響

自2020年第一季度以來，COVID-19疫情的爆發對全球經濟造成不利影響。為此，政府部門採取多項防疫措施，包括出行禁令及限制、檢疫措施及遠程工作安排。自2023年以來，疫情的不利影響逐漸消退。

通過主要與領先供應商的合作，我們的供應鏈保持穩定，採購的原材料及服務價格並無出現重大波動。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因COVID-19疫情而遭遇任何重大業務營運停擺，且我們的產品交付並無受到COVID-19疫情的重大影響。因此，我們認為COVID-19的爆發並未對我們的業務、財務狀況或經營業績產生任何重大不利影響。

[編纂]

	根據[編纂]為 每股H股[編纂]港元	根據[編纂]為 每股H股[編纂]港元
我們的H股市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
我們的A股和H股市值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
截至2025年12月31日本公司擁有人應佔 本集團每股未經審計備考經調整綜合 有形資產淨值 ⁽³⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) 計算乃基於假設[編纂]將新發行[編纂]股H股（未計及因[編纂]獲行使而可能發行的H股，且自最後實際可行日期至上市日期期間本公司已發行股本不作其他變動）。
- (2) 市值的計算乃基於緊隨[編纂]完成後預期將發行[編纂]股股份（假設[編纂]未獲行使）。
- (3) 截至2025年12月31日，本公司擁有人應佔本集團每股未經審計備考經調整綜合有形資產淨值乃並基於合共[編纂]股股份（假設[編纂]已於2025年12月31日完成，但未計因[編纂]獲行使及根據受限制股份計劃已經或可能不時授出的受限制股份歸屬時而可能發行的任何股份）計算。詳情請參閱附錄二－未經審計備考財務資料。
- (4) 截至2025年12月31日，概無就本公司擁有人應佔本集團未經審計備考經調整綜合有形資產淨值作出調整，以反映本集團於2025年12月31日後的任何經營業績或所訂立的其他交易（包括誠如本文件附錄一會計師報告附註47所載收購芯邁微100%的股權及宣派股息）。

概 要

所得款項用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），經扣除[編纂]及我們就[編纂]已付及應付的其他估計開支後（假設[編纂]未獲行使），我們估計將收取[編纂]所得款項淨額約[編纂]港元。

基於我們的戰略，我們擬按下文所載用途及金額運用[編纂]所得款項：(i)約[70.0]%或[編纂]港元計劃在未來五年用於支持持續增長與提升我們的研發能力，專注於尖端芯片技術；(ii)約[10.0]%或[編纂]港元擬用於未來五年的全球客戶服務體系建設；(iii)約[10.0]%或[編纂]港元擬用於推進「平台+生態系統」戰略的戰略投資與收購；及(iv)約[10.0]%或[編纂]港元將用於一般營運資金及一般公司用途。請參閱「未來計劃及所得款項用途」。

股息

根據中國法律法規（包括《中華人民共和國公司法》）及組織章程細則，我們已採納年度股息政策。截至最後實際可行日期，我們並無固定股息分派率。我們優先以現金方式分派股息，但亦可能以股票或現金與股票混合的方式分派股息。根據組織章程細則，董事會經考慮我們的經營業績、財務狀況、運營要求及資本需求後可推薦派發股息。根據中國適用法律，股息僅可以可分派利潤支付，即經扣除任何彌補的累計虧損及法定公積金必需分配額的除稅後利潤。於往績記錄期間，我們於2023年、2024年及2025年分別向股東宣派股息人民幣208.2百萬元、零及零。於往績記錄期間宣派的所有有關股息均已於截至最後實際可行日期悉數結清。

上市開支

上市開支指就[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用。我們將承擔的上市開支估計約為人民幣[編纂]元（[編纂]港元），包括：(i)[編纂]人民幣[編纂]元（[編纂]港元）；及(ii)[編纂]開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元），其進一步分類為：(a)法律顧問及會計師的費用及開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元）；及(b)其他費用及開支人民幣[編纂]元（[編纂]港元），假設[編纂]未獲行使及按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）計算，其中約人民幣[編纂]元（[編纂]港元）已經或預期將自我們的綜合

概 要

損益表扣除，以及約人民幣[編纂]元（[編纂]港元）預期將於[編纂]完成後自權益扣除。假設按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）計算及[編纂]未獲行使，上市開支預期將佔[編纂]所得款項總額的約[編纂]%。上述上市開支為最新的實際可行的估計，僅供參考，且實際數額可能會與本估計不同。

出口管制合規安排

於往績記錄期間，身為一家半導體設計公司，我們委託第三方晶圓廠提供晶圓製造服務，並在研發過程中採用來自第三方供應商的架構IP、設計軟件及工具。該等海外晶圓廠、IP廠商、設計軟件與工具廠商部分受美國不同層級的出口管制法規規範，此將影響其客戶篩選及供應鏈管理方式。為維持我們的競爭優勢、可持續發展及遵循法規，我們已透過與主要股東Amlogic Holdings Ltd.的關係，藉由出口管制合規安排（定義見下文）優化業務營運。請參閱「業務－法律訴訟及合規情況－出口管制合規安排」、「關連交易」及「風險因素－與我們的行業及業務營運有關的風險－我們面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施、出口管制及經濟制裁相關的風險，且我們的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響」。

經諮詢國際制裁法律顧問後，董事認為，我們的出口管制合規安排一直並將持續符合適用的美國出口管制法規。